

2023年5月15日

各 位

## 次世代半導体実装用特殊キャリア「HRDP®」の設備増強について

～ ジオマテック株式会社赤穂工場に第2ライン導入およびDOE設備拡充 ～

当社（社長：納 武士）は、次世代半導体実装用特殊キャリア「HRDP®」<sup>※1</sup>について、ジオマテック株式会社（社長：松崎 建太郎）と協働で商品化に向けた量産体制を構築してまいりました。この度、当社はジオマテック株式会社 赤穂工場内に第2ライン導入の生産能力増強およびDOE設備<sup>※2</sup>の拡充に関わる投資を決定したので、お知らせいたします。

当社が開発した「HRDP®」は、 $L/S=2/2\mu\text{m}$ 以下の超高密度設計を実現できる特殊キャリアです。

現在、主要な大手半導体メーカー複数社において、当社HRDP®を適用した次世代半導体パッケージ開発が本格的に開始されております。このような状況を受け、さらなる品質向上と生産能力増強のため、2025年稼働予定でジオマテック株式会社 赤穂工場内にHRDP®の第2ライン導入を決定いたしました。なお、第2ラインの成膜工程部分については、協働しているジオマテック株式会社が当社と同時期に設備投資を実施します。

加えて、既に稼働しているDOE設備を拡充することで、HRDP®を用いたお客様との協働開発を加速させることができます。これにより、お客様におけるサイクルタイム<sup>※3</sup>の最短化が可能となります。

今回の第2ライン導入およびDOE設備の拡充により、加速する開発需要に迅速に対応し、今後の次世代半導体市場における量産採用および拡大に繋げてまいります。なお、今回の設備投資は2023年から2025年にかけて順次実施いたします。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、HRDP®の事業拡大により半導体パッケージ市場への貢献を進めるとともに、事業活動を通じ、サステナブルな社会作りに貢献します。

以上



写真 1 : 300mm ウエハー形状 HRDP®製品 (製品出荷専用ケース)



写真 2 : 600mm パネル形状 HRDP®製品を用いたモールド樹脂封止後の  
半導体パッケージ作製中の基板 (ライン/スペース 2/2 $\mu$ m RDL<sup>※4</sup>適用品)

**【お問い合わせ先】**

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E メール : [PR@mitsui-kinzoku.com](mailto:PR@mitsui-kinzoku.com)

## 【用語説明】

- ※1 High Resolution De-bondable Panel の略
- ※2 Design of Experiments : 顧客デザインを検証することで、様々な課題を事前に把握し解決する為の開発設備
- ※3 顧客の工程設計において最も重要な要素である半導体パッケージ製造にかかる工程数や時間
- ※4 Re-Distribution Layer (再配線層)

## 【ご参考】

「ファンアウト・パネルレベルパッケージ用ガラスキャリア付き微細回路形成用材料 HRDP®を開発」  
(2018年1月25日付リリース)

[https://www.mitsui-kinzoku.com/Portals/0/resource/uploads/topics\\_180125.pdf?TabModule950=1](https://www.mitsui-kinzoku.com/Portals/0/resource/uploads/topics_180125.pdf?TabModule950=1)

「次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP®」を量産開始」(2021年1月25日付リリース)

[https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=fcgXzc5Wp\\_jw%3d&tabid=199&mid=826&TabModule950=1](https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=fcgXzc5Wp_jw%3d&tabid=199&mid=826&TabModule950=1)

「次世代半導体チップ実装用特殊キャリア「HRDP®」の海外向け量産開始」(2021年12月14日付リリース)

<https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=dzzlQjh5x8I%3d&tabid=199&mid=826&TabModule950=1>

HRDP®を利用した、チップラスト工法のイメージ動画

<https://www.youtube.com/watch?v=vHhng-NV9QA>